

# 500°C超高温自動卓上ホットプレス 5トン 180×180Mmプラテン

商品番号: XP66



## 前書き

5トンの加圧力、180×180mmプラテン、一体型水冷システムを備えた全自動油圧制御の500°C対応超高温卓上ホットプレスです。高分子、複合材料、電池および先端材料研究に最適で、正確かつ安定した熱処理結果を実現します。

## 詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
高性能高分子成形	ポリイミド (PI)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、その他の高温熱可塑性樹脂やフッ素樹脂の加工。これらの材料は、成形、硬化またはフィルム形成のために最大500°Cの持続的な温度を必要とします。	均一な材料流動と結晶化を実現し、内部応力や寸法誤差を最小限に抑えます。
先進セラミック・ガラス焼結	ガラス粉末、結晶化ガラス、電子セラミックスの低温接合、予備焼結、熱処理を制御された圧力下で行えます。	先進無機材料の試作に必要な正確な高密度化と微細組織形成を可能にします。
固体電池界面工学	全固体電池における正極/固体電解質/負極層の熱圧着に対応。界面抵抗低減のために高温と均一圧力が必要とされる工程に適しています。	セルのイオン伝導性と機械的完全性を向上させ、固体電池の研究開発を加速します。
多層複合材ラミネーション	航空宇宙・電子分野向けの先進プリプレグ、金属高分子積層板、構造用複合材の高温硬化・接合。	ボイドがなく、均一性の高い積層板を製造し、優れた機械的・熱的特性を実現します。
高分子フィルム・膜製造	濾過、エネルギー、センサー用途向け高温高分子フィルムのカレンダー加工・圧縮加工。正確な厚みと気孔制御が必須となる工程に適しています。	厳しい公差と安定した品質を持つフィルムを生産でき、スケラブルな研究に適しています。
電子パッケージ・アンダーフィル	半導体・PCB実装向け接着剤、封止材、アンダーフィル材の高温硬化。	ボイドのない接合と安定した熱サイクル耐性を確保します。
繊維強化複合材研究開発	炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維強化の熱可塑性または熱硬化性複合材試験片の作製、機械特性評価に対応。	制御された圧力と熱の下で積層構成の迅速な試作と試験を可能にします。
一般材料研究・サンプル調製	大学・産業研究所で機械試験、分光分析または顕微鏡観察用のサンプルを調製するための多目的プラットフォームです。プログラム可能なサイクルにより標準化された調製を実現します。	ワークフローを合理化し再現性を高め、研究室の生産性を向上させます。

パラメータ	仕様	備考
モデル	XP66	旧名称：PCH-5T1818A / PCAH-5T1818A
運転方式	全自動油圧制御	ワンボタンでの型閉め、加圧、プログラム加熱に対応
最大加圧力	0 - 5 トン (0 - 50 kN)	高精度な圧力調整可能
使用温度範囲	0 - 500°C (最大500°C)	高温材料研究開発向け超高温構成
加熱出力	1500 W	滑らかな加熱、優れた断熱性能
プラテンサイズ	180 × 180 mm	コンパクトなデュアルゾーン加熱プレート
最大面圧	約15.4 Bar (1.54 MPa)	精密ラミネーションや高分子フィルム硬化に適しています

パラメータ	仕様	備考
冷却方式	循環水冷	使用温度が150°Cを超える場合は冷水チャラーの接続必須
電源	AC 220V / 50Hz (単相)	動作電流 約6.8 A、プラグアンドプレイ
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	290 × 290 × 420 mm	卓上縦型コンパクト構造
正味重量	90 kg	重心集中設計；二人での運搬を推奨